

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 6 月 9 日 (09.06.2005)

PCT

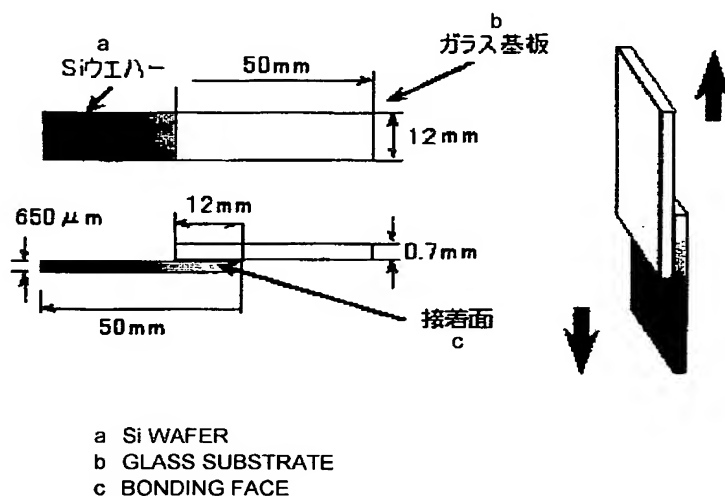
(10) 国際公開番号
WO 2005/052085 A1

- (51) 国際特許分類⁷: C09J 201/00, 11/06, H01L 21/68 (71) 出願人 (米国についてののみ): 横山 路子 (YOKOYAMA, Michiko) (発明者 (死亡) の相続人) [JP/JP]; 〒5121216 三重県四日市市桜花台二丁目 3 5 番 1 5 号 Mie (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/017449
- (22) 国際出願日: 2004 年 11 月 25 日 (25.11.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語 (72) 発明者: 横山 泰明 (YOKOYAMA, Yasuaki) (死亡).
- (26) 国際公開の言語: 日本語 (72) 発明者; および
- (30) 優先権データ: 特願 2003-397871 2003 年 11 月 27 日 (27.11.2003) JP (75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 保田 慶友 (YASUDA, Kyouyu) [JP/JP]; 〒1040045 東京都中央区築地五丁目 6 番 1 0 号 JSR 株式会社内 Tokyo (JP). 伊藤 信幸 (ITO, Nobuyuki) [JP/JP]; 〒1040045 東京都中央区築地五丁目 6 番 1 0 号 JSR 株式会社内 Tokyo (JP).
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): JSR 株式会社 (JSR CORPORATION) [JP/JP]; 〒1040045 東京都中央区築地五丁目 6 番 1 0 号 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: HOT MELT ADHESIVE COMPOSITION

(54) 発明の名称: ホットメルト型接着剤組成物



(57) Abstract: [PROBLEMS] To provide an adhesive composition employed to fix a semiconductor wafer or the like onto a support base, which adhesive composition exhibits firm adherence of high thermal stability at the time of grinding operation but after the completion of grinding operation, is melted by heating to thereby permit easy detachment. [MEANS FOR SOLVING PROBLEMS] There is provided a hot melt adhesive composition comprising as a main component a crystalline compound of 50 to 300°C melting temperature, characterized in that the composition has a melting temperature width of 30°C or less and a melt viscosity of 0.1 Pa·s or below. It is preferred that the crystalline compound as the main component be an organic compound of 1000 or less molecular weight composed of C, H and O elements only, especially an aliphatic compound or alicyclic compound, and still especially a compound having a steroid skeleton and/or hydroxyl.

(57) 要約: [課題] 半導体ウエハーなどを支持基板に固定化する接着剤組成物であって、研削工程時には堅固で高耐熱の接着能を有するとともに、研削工程終了後においては、加熱溶融することにより容易に剥離することが可能な接着剤組成

[続葉有]



(74) 代理人: 鈴木 俊一郎 (SUZUKI, Shunichiro); 〒1410031
東京都品川区西五反田七丁目 1 3 番 6 号 五反田山
崎ビル 6 階 鈴木国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,
SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可
能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

物を提供すること。〔解決手段〕 本発明のホットメルト型接着剤組成物は、溶融温度が 50～300℃である結晶性化合物を主成分として含む組成物であって、該組成物の溶融温度幅が 30℃以下、溶融粘度が 0.1 Pa・s 以下であることを特徴とする。主成分である結晶性化合物は、C、H、O の元素のみからなる分子量 1000 以下の有機化合物、好ましくは脂肪族化合物または脂環式化合物、特に好ましくはステロイド骨格および／または水酸基含有化合物であることが望ましい。